行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

高功率微波電晶體之研究

Study of High Power Microwave Transistors

計劃編號:NSC 88-2213-E009-137

執行期限:民國 87 年 08 月 01 日起至民國 88 年 07 月 31 日

主持人: 李建平教授

一、中文摘要

在本年度的國科會計劃中, 本實驗室提出了製作高功率微波電晶 體的研究計劃,而這一年的研究計劃執 行中,獲致良好的結果,並針對所製作 出來的高功率微波電晶體 P-HEMT 在 CDMA 系統應用的研究,我們針對 Single 和 Double delta doping 這兩種 結構量測其,Small Signal, Large Signal, Characterization, Power linear Characterization,發現 Double delta doping 結構的 Characterization 要比 Single delta doping 的 Characterization 來的好。因此,綜合上所述我們可以 知道在 RF 功率放大器的應用上 Double delta doping 要比 Single delta doping 為佳。此外,本研究為第一次 發表針對 Double delta doping 和 Single delta doping 這兩種不同的結構 在 CDMA 通訊系統上的線性應用比 較,且也獲得不錯的結果。

Abstract

In this project, we have developed the processing techniques for GaAs psedomorphic HEMTs. In this

study, we compare the performance of single delta doping structure and double delta doping structure in DC - Small signal and Large signal analysis. At 300K, the gm and Idss of the single delta doping structure were 244mS/mm and 152mA/m, respectively. For the double delta doping structure, the gm and Idss of single delta doping structure were 247mS/mm and 260mA/m, respectively. For double delta doping structure, the ft and fmax were 16~17GHz and 50GHz, respectively. In large signal measurement, the power added efficiency > P1dB and OIP3 of single delta doping structure were 32% -2.59dBm and 26.91dBm, respectively. For double delta doping structure, the power added efficiency > P1dB and OIP3 of single delta doping structure were $37\% \sim 0.74$ dBm and 27.65dBm, respectively. For applications in CDMA communication systems, we have measured the adjacent channel power leakage ratio (ACPR) of single and double delta doping structure. We found

that the ACPR of double delta doping structures is better than that of single delta doping structures. Based on this study, we can conclude that for the linearity applications double delta doping structures are more suitable than single delta doping structures. This is the first time that direct comparison is made for different delta doped PHEMT structures for CDMA power applications.

二、緣由與目的

在微波通訊系統中, 訊號經由天 線收集後,經過RF 放大器、濾波器、 混波器、中頻放大器、最後輸入至訊 號處理電路、以轉成人們可閱讀的資 訊。由上述系統可知微波半導體元件 及電路無疑地是整個微波通訊系統中 的重要角色。目前用在無線通訊的半 導體元件,在 Silicon 方面主要有 MOSFET 、 CMOS FET 、 Bipolar Transistor; Ⅲ - V 族 方 面 則 有 MESFET、P-HEMT、HBT 等。以 Silicon 為基底的高速元件,理論極限預測在 5GHz,實際能到達 3GHz 已非常困 難。但相對的,以Ⅲ-V族半導體為基 底的高速元件,10~30GHz 或更高的通 訊頻率,則是輕而易舉。在傳統的場 效電晶體(MESFET)中,由於其傳導 的載子與摻雜的原子處於相同的空間 上,一旦增加載子濃度時,摻雜濃度 也隨著增加。相對的載子與游離化摻 雜原子間的作用力也增強,因而降低 了元件的高频特性。然而高電子遷移 率電晶體(HEMT or P-HEMT)藉由其 特殊的垂直結構所形成的二維電子通 道,則可去除 MESFET 的上述缺點,

也就是 HEMT 的高頻特性幾乎都比 MESFET 來的好。因此我們在這個計 劃中研究了 PHEMT 的高頻及大訊號 的特性,針對 CDMA 系統的線性要求 來製作高功率的 PHEMT 元件。

三、結果與討論

我們這個計劃主要提出了針 對 P-HEMT 應用在最新的無線通訊系 統 CDMA 中,最重要的一個特性,那就 是元件的線性,在 CDMA 的系統中放 大器不僅要達到高的功率輸出,且在不 同的的功率輸出下,仍要能夠維持好的 線性輸出,因此本計劃針對這一個想法, 改變 P-HEWIT 的磊晶結構,希望能提出 一個提昇 CDMA 線性規格的元件結構, 我們比較了 Single delta doping 及 double delta doping 的元件結構,我們 從元件的 DC 直流分析(Fig.1(a)(b))可 以看出在小的汲極電壓時可看出元件 的內在特,發現 Double delta doping 的 結構有比較平坦的 gm 表現,表示 Double delta doping 天生就應比 Single delta doping 有更好的線性表現,接下 來我們針對元件的小訊號作量測,了解 元件的小訊號S 參數,發現 Double delta doping 的高頻特性較 Single delta doping 更不易改變,由此我們可以看 出一些元件應用在高頻線性放大器的 端倪,接下來我們用較直接的方法來量 測這二個結構的線性好壞,使用 One tone (Fig.2(a))及 two tone(Fig.2(b)) 的 量法,我們發現結如下:

	Single	Double
P1dB	-2.59dBm	0.75dBm
OIP3	26.91dBm	27.65dBm
從上面的量測結果我們可以知道		
Double Delta doping 的結構在線性的		

應用上比 Singel Delta doping 的結構 還要好,但這些量測都不是直接的証明 說 Double Delta doping 的線性比 Single Delta doping 的線性好,因此由於元件 是應用在 CDMA 的通訊系統中,所以 我們針對這二種結構的件,輸入一個數 位調變的高頻信號,即 CDMA pattern, 量測其 ACPR(Adjust Cannel leakage Power Rejection)值(Fig3),發現我們的 推論結果是正確的,即 Double Delta doping 的 PHEIMT 結構比 Single Delta doping 的結構能獲得更好的線性特 性。

四、參考文獻

1. R. Dingle,H.L. Stormer "Electron mobility in modulation-doped semiconductorsuperlattices ", Appl.Ph ys.Lett.,vol.33,P655-667, 1978.

2. R. Dingle,H.L. Stormer "Two dimensional electron gas at a semiconductor interface", Solid-state Comm.vol.29,P665-667, 1979.

3. TMimura, S. Hiyamiza, Japan. J. Appl. Phs.vol. 19, L225-227, 1980

4. A. Ketterson, M Moloney, "High transconductance InGaAs/AlGaAs Pseudormorphic modulation-doped field-effect transistors", IEEE, Electron Device Lett.vol.EDL-6, P628-630, 1985.

5. M. Muraguchi, M. Nakatsugawa, H.Hayashi, and M. Aikawa, "A 1.9GHz-band ultra low power comsumption amplifier chip set for personal communications."in *IEEE MTT-S* Dig., 1995.pp.9-12.

6. P.O'Sullivan, G.St. Ongc, F. Heancy, F.

McGrath, and C. Kermarrce, "High performance integrated PA, T/R switch for 1.9GHz personal communication handsets." *In GaAs IC Symp. Tech. Dig.*, 1993 pp. 33-35.

7. T. YoKoyama, T. Kunihisa, M. Nishijima, S. Yamamoto, M. Nishitsuji, K. Nishii, M. Nakayama, and O. Ishikawa. "Low current dissipation pseudomorphic MODFET MIMIC power amplifier for PHS operation with a 3.5V single voltage supply," in GaAs IC Symp. Tech. Dig, 1996, pp. 107-110.

8. H. Ono,Y. Umemoto, M. Mori,M Miyazaki,A. Terano, and M Kudo, "Pseudomorphic power HEMT with 53.5% power-added efficiency for 1.9GHz PHS standards," in IEEE MTT-S Dig., 1996, pp. 547-550.

9. M. Hirose, K. Nishihori, M. Nagakoa, Y. Ikeda, A. Kameyama, Y. Kitaura, and N. Uchitomi, "A symmetric GaAs MESFET structure with a single low-voltage supply," in GaAs IC Symp. Tech. Dig., 1996 pp. 237-240.

10. T. Kunihisa T. Yokoyama, H. Fujimoto K. Ishida, H, Takchara, and O. Ishikawa, "High efficiency, low adjacent channel leakage GaAs power MIMIC for digital cordless telephone," in IEEE MTT-S Dig., 1994, pp. 55-58.



